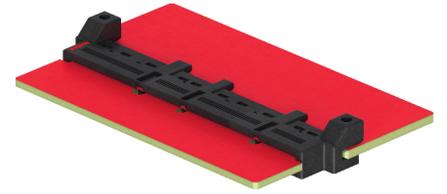


Silver Edge Card插座和电缆组件

多功能Silver Edge Card插座和电缆组件符合小型化委员会（SFF）、开放计算项目（OCP）和Gen-Z联盟的标准，并获得这些组织的认可。该产品有多种配置，可有效连接各种高速板对板电路、铜质软排线和电缆



Silver Edge Card夹板连接器

特点与优点

具有多功能，可跨接多个平台

可连接存储器电路、配件卡和正交直连结构。鉴于其用途广泛，用户可大批量购买该连接器以满足各种需要

端子间距小，仅为0.60毫米

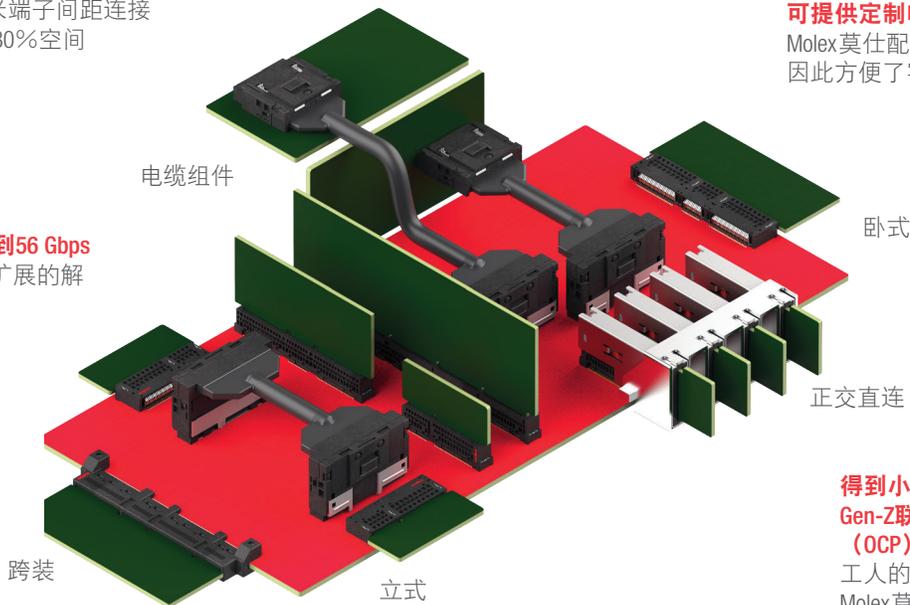
与传统的0.80毫米端子间距连接器相比，可节省30%空间

可提供定制电缆组件

Molex莫仕配套提供电缆组件，因此方便了客户的采购工作

32 Gbps，计划达到56 Gbps

用作分档的、可扩展的解决方案



得到小型化委员会（SFF）、Gen-Z联盟和开放计算项目（OCP）认可

工人的高端水准。Molex莫仕解决方案被公认为成熟的行业标准解决方案

市场与应用场合

电信/网络

- 服务器
- 机架
- 夹层板

智能手机和移动设备

- 移动设备
- AR/VR头戴设备

联网家庭

- 物联网设备



数据中心



AR/VR头戴设备

技术参数

参考信息

包装：托盘包装
UL文件编号：待定
CSA档案编号：待定
对配器件：电路板银触点边缘
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤素：是
是否耐受灼热丝高温：否

电器参数

电压（最大值）：29伏交流（有效值）
/直流
电流（最大值）：每个引脚1.1安
接触电阻：15毫欧，增量
绝缘耐压：300伏交流
绝缘电阻（最大值）：1000兆欧

机械参数

端子插合力（最大值）：每对引脚1.1牛
拔脱力（最小值）：每对引脚0.08牛
可插拔次数（最小值）：200次

物理参数

外壳：LCP塑料
触点：铜合金
电镀：铜合金上镀镍，然后镀金
接触部位 - 0.76微米（30微英寸）镀金
焊尾部位 - 2.54微米（100微英寸）镀锡
底层电镀 - 1.27微米（50微英寸）镀镍
电路板厚度：1.57毫米（0.062英寸）
工作温度：-45至+ 85摄氏度